

杭州立昂微电子股份有限公司

关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

上海证券交易所：

根据贵所印发的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作(2023 年 12 月修订)》及相关格式指引的要求，现将本公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额、资金到账时间

1. 2021 年 10 月非公开发行股票

公司经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州立昂微电子股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2021]2740 号)，由联席主承销商东方证券承销保荐有限公司联席中信证券股份有限公司和中国国际金融股份有限公司采用代销方式，向 22 名特定对象发行了人民币普通股(A 股) 56,749,972 股，发行价格人民币 91.63 元/股，募集资金合计 519,999.99 万元。根据公司与主承销商东方证券承销保荐有限公司、联席中信证券股份有限公司和中国国际金融股份有限公司签订的承销与保荐协议，公司应支付承销费用、保荐费用含税合计 4,287.70 万元(其中不含税金额为 4,045.00 万元，增值税进项税额为 242.70 万元)，其中应分别支付东方证券承销保荐有限公司承销费用、保荐费用 3,232.80 万元(含税)，中信证券股份有限公司承销费用 275.19 万元(含税)和中国国际金融股份有限公司承销费用 779.71 万元(含税)；公司募集资金扣除应支付东方证券承销保荐有限公司的承销费用、保荐费用 3,232.80 万元(含税)后的余额 516,767.20 万元已于 2021 年 10 月 8 日分别存入公司开立的各募集资金专户。另减除律师费、审计验资费、发行手续费和印花税等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用后，公司本次募集资金净额为 515,218.33 万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其于 2021 年 10 月 11 日出具了《验资报告》(中汇会验[2021]7259 号)。

2. 2022 年 11 月立昂转债

本公司经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州立昂微电子股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2022]2345 号)核准，由主承销商东方证券承销保荐有限公司采用余额包销的方式，公开发行可转换公司债券 3,390.00 万张，每张面值 100 元，共计募集资金人民币 339,000.00 万元，扣除承销和保荐费用(含税)1,060.00 万元后的募集资金 337,940.00 万元，已由主承销商东方证券承销保荐有限公司于 2022 年 11 月 18 日汇入本公司

募集资金监管账户。本次公开发行可转换公司债券发行承销保荐费及其他发行费用(不含税)共计人民币 1,187.59 万元,本次公开发行可转换公司债券认购资金总额扣减上述发行费用(不含税)后募集资金净额为人民币 337,812.41 万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并由其于 2022 年 11 月 18 日出具了《验资报告》(中汇会验[2022]7581 号)。

(二) 募集金额使用情况和结余情况

1. 2021 年 10 月非公开发行股票

2021 年度,公司募集资金投资项目使用募集资金 318,813.62 万元。

2022 年度,公司募集资金投资项目使用募集资金 163,288.94 万元,募集资金支付发行费用 128.84 万元。

2023 年度,公司募集资金投资项目使用募集资金 31,356.53 万元。

2023 年 12 月 14 日,公司披露了《关于 2021 年非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号 2023-089),公司 2021 年 10 月非公开发行股票募投项目实施完毕,本次募投项目全部结项,公司拟将 2021 年非公开发行股票募投项目节余募集资金 4,316.47 万元(实际金额以资金转出当日专户余额为准)永久补充流动资金。

截至 2023 年 12 月 31 日,公司尚有节余募集资金 3,759.99 万元(含利息收入扣除银行手续费的净额)尚未从募集资金存放专项账户转出。

2. 2022 年 11 月立昂转债

2022 年度,公司募集资金投资项目使用募集资金 102,236.51 万元,募集资金支付发行费用 127.59 万元。

2023 年度,公司募集资金投资项目使用募集资金 74,726.96 万元。

截至 2023 年 12 月 31 日止,结余募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净额)余额为 118,337.00 万元。

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者利益,本公司根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》《上海证券交易所股票上市规则(2023 年 8 月修订)》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作(2023 年 12 月修订)》等有关法律、法规和规范性

文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《杭州立昂微电子股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同主承销商东方证券承销保荐有限公司分别与宁波银行股份有限公司杭州城东支行、兴业银行股份有限公司宁波北仑支行、中国农业银行股份有限公司宁波保税区支行、招商银行股份有限公司衢州分行、中国工商银行股份有限公司衢州衢江支行和上海浦东发展银行宁波鄞州支行签订了相关的募集资金监管协议，明确了各方的权利和义务。相关的募集资金监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

（二）募集资金的专户存储情况

1. 2021年10月非公开发行股票

截至2023年12月31日止，本公司非公开发行股票有6个募集资金专户和2个募集资金保证金户，募集资金存储情况如下(单位：人民币元)：

开户银行	银行账号	账户类别	账户名称	存储余额	备注
兴业银行股份有限公司宁波北仑支行	388010100101681858	募集资金专户	杭州立昂微电子股份有限公司	-	已注销
宁波银行股份有限公司杭州城东支行	71060122000538713	募集资金专户	杭州立昂微电子股份有限公司	-	已注销
中国农业银行股份有限公司宁波保税区支行	39310001040013388	募集资金专户	杭州立昂微电子股份有限公司	-	已注销
上海浦东发展银行宁波鄞州支行	94170078801600002029	募集资金专户	杭州立昂微电子股份有限公司	-	已注销
宁波银行股份有限公司杭州城东支行	71060122000538866	募集资金专户	金瑞泓微电子(衢州)有限公司	9,898,534.44	-
中国工商银行股份有限公司衢州衢江支行	1209260629200133058	募集资金专户	金瑞泓科技(衢州)有限公司	-	已注销
宁波银行股份有限公司杭州分行	7101009900024392600001	募集资金保证金户	金瑞泓微电子(衢州)有限公司	27,701,349.96	-
中国工商银行股份有限公司衢州衢江支行	1209260641000004794	募集资金保证金户	金瑞泓科技(衢州)有限公司	-	已注销
合计				37,599,884.40	

注：2023年12月14日，公司披露了《关于2021年非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号2023-089），公司2021年10月非公开发行股票募投项目实施完毕，本次募投项目全部结项，公司拟将2021年非公开发行股票募投项目

节余募集资金 4,316.47 万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金；截至 2023 年 12 月 31 日，公司尚有节余募集资金 3,759.99 万元（含利息收入扣除银行手续费的净额）尚未从募集资金存放专项账户转出。

2. 2022 年 11 月立昂转债

截至 2023 年 12 月 31 日止，本公司公开发行可转换公司债券有 5 个募集资金专户和 2 个募集资金保证金户，募集资金存储情况如下（单位：人民币元）：

开户银行	银行账号	账户类别	账户名称	存储余额	备注
宁波银行股份有限公司杭州城东支行	71060122000594365	募集资金专户	杭州立昂微电子股份有限公司	3,190,132.47	-
宁波银行股份有限公司杭州城东支行	71060122000594421	募集资金专户	金瑞泓微电子(衢州)有限公司	693,579,965.35	-
招商银行股份有限公司衢州分行	571900276410809	募集资金专户	杭州立昂微电子股份有限公司	3,607,296.23	-
招商银行股份有限公司衢州分行	570900397310808	募集资金专户	金瑞泓科技(衢州)有限公司	211,370,430.99	-
兴业银行股份有限公司宁波北仑支行	388010100101880777	募集资金专户	杭州立昂微电子股份有限公司	157,711.40	-
招商银行股份有限公司衢州分行	57090039731100012	募集资金保证金户	金瑞泓科技(衢州)有限公司	179,448,631.79	-
宁波银行股份有限公司杭州分行	7108009900007663500001	募集资金保证金户	金瑞泓微电子(衢州)有限公司	92,015,837.80	-
合计				1,183,370,006.03	

三、本年度募集资金的实际使用情况

2023 年度《募集资金使用情况对照表》详见本报告附件 1。

(一) 募集资金投资项目的资金使用情况。

1. 募投项目涉及的市场环境发生重大变化的；

募集资金投资项目涉及的市场环境未发生重大变化。

2. 募投项目搁置时间超过 1 年的；

募集资金投资项目搁置时间未超过 1 年。

3. 超过募集资金投资计划的完成期限且募集资金投入金额未达到相关计划金额 50%的；

不存在超过募集资金投资计划的完成期限且募集资金投入金额未达到相关计划金额 50%的情况。

4. 募投项目无法单独核算效益的；

募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。

5. 募投项目出现其他异常情况的。

募集资金投资项目不存在其他异常情况。

(二) 募集资金投资项目先期投入及置换情况。

1. 2021 年 10 月非公开发行股票

为保障募集资金投资项目顺利执行，在募集资金到位之前，公司根据项目建设的需要，已使用自有资金先行投入募投项目。公司 2021 年 12 月 9 日第四届董事会第六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金人民币 110,222.28 万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。上述募集资金置换情况已由中汇会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于杭州立昂微电子股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(中汇会鉴[2021]7848 号)。上述募集资金已于 2021 年 12 月 10 日全部置换完毕。

2. 2022 年 11 月立昂转债

为保障募集资金投资项目顺利执行，在募集资金到位之前，公司根据项目建设的需要，已使用自有资金先行投入募投项目。公司 2022 年 12 月 16 日第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金人民币 16,099.06 万元，置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。上述募集资金置换情况已由中汇会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于杭州立昂微电子股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(中汇会鉴[2022]7724 号)。上述募集资金已于 2022 年 12 月 27 日全部置换完毕。

(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

1. 2021 年 10 月非公开发行股票

2021 年度，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

2022 年度，公司使用 22,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，本期归还暂时补充流动资金 11,000.00 万元。

2023 年度，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金，本期归还暂时补充流动资金 11,000.00 万元。

截止 2023 年 12 月 31 日，暂时补充流动资金的闲置募集资金已全部归还。

2. 2022 年 11 月立昂转债

2022 年度，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

2023 年度，公司存在使用 45,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

截止 2023 年 12 月 31 日，公司仍有 45,000.00 万元暂时补充流动资金的闲置募集资金尚未归还。

(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

报告期内，公司本期不存在用闲置募集资金进行现金管理的情况。

(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(六) 超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

(七) 节余募集资金使用情况。

2023 年 12 月 14 日，公司披露了《关于 2021 年非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号 2023-089)，公司 2021 年 10 月非公开发行股票募投项目实施完毕，本次募投项目全部结项，公司拟将 2021 年非公开发行股票募投项目节余募集资金 4,316.47 万元(实际金额以资金转出当日专户余额为准)永久补充流动资金。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司已实际使用节余募集资金永久补充流动资金 559.95 万元，尚有节余募集资金 3,759.99 万元(含利息收入扣除银行手续费的净额)尚未从募集资金存放专项账户转出。

(八) 募集资金使用的其他情况。

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已经披露的募集资金相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况；已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

附件：1. 募集资金使用情况对照表

杭州立昂微电子股份有限公司董事会

2024年4月22日

附件 1-1

募集资金使用情况对照表

(2021 年 10 月非公开发行股票)
2023 年度

编制单位：杭州立昂微电子股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额		519,999.99		本年度投入募集资金总额		31,356.53							
变更用途的募集资金总额		不适用		已累计投入募集资金总额		513,459.09							
变更用途的募集资金总额比例		不适用											
承诺投资项目	已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	截至期末承诺投入金额	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2) [注 1]	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3) = (2) - (1)	截至期末投入进度(%) (4) = (2) / (1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化	
年产 180 万片集成电路用 12 英寸硅片	-	228,800.00	228,800.00	未做分期承诺	18,703.04	226,418.70	-2,381.30	已结项	2023 年 12 月	-30,240.58	否[注 3]	否	
年产 72 万片 6 英寸功率半导体芯片技术改造项目	-	78,422.00	78,422.00	未做分期承诺	10,955.29	79,005.73	[注 2]583.73	已结项	2023 年 12 月	13,916.90	是	否	
年产 240 万片 6 英寸硅外延片技术改造项目	-	62,778.00	62,778.00	未做分期承诺	1,698.20	62,687.49	-90.51	已结项	2024 年 2 月	5,728.54	否[注 4]	否	
补充流动资金	-	149,999.99	149,999.99	未做分期承诺	0.00	145,347.17	-4,652.82	已结项	不适用			否	
合计		519,999.99	519,999.99		31,356.53	513,459.09	-6,540.90	-					
未达到计划进度原因				-									

项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	为保障募集资金投资项目顺利执行，在募集资金到位之前，公司根据项目建设的需要，已使用自有资金先行投入募投项目。公司 2021 年 12 月 9 日第四届董事会第六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金人民币 110,222.28 万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。上述募集资金置换情况已由中汇会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于杭州立昂微电子股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(中汇会鉴[2021]7848 号)。上述募集资金已于 2021 年 12 月 10 日全部置换完毕。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	不适用
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
项目资金结余的金额及形成原因	2023 年 12 月 14 日，公司披露了《关于 2021 年非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号 2023-089)，公司 2021 年 10 月非公开发行股票募投项目实施完毕，本次募投项目全部结项，公司拟将 2021 年非公开发行股票募投项目节余募集资金 4,316.47 万元(实际金额以资金转出当日专户余额为准)永久补充流动资金。截至 2023 年 12 月 31 日，公司已实际使用节余募集资金永久补充流动资金 559.95 万元，尚有节余募集资金 3,759.99 万元(含利息收入扣除银行手续费的净额)尚未从募集资金存放专项账户转出。
募集资金其他使用情况	不适用

[注 1] 公司 2021 年 10 月非公开发行股票募集资金投资项目截至 2023 年 12 月 31 日募集资金累计投入金额 513,459.09 万元，该金额不包含已支付的发行费用 4,781.67 万元。

[注 2] “年产 72 万片 6 英寸功率半导体芯片技术改造”项目截至 2023 年 12 月 31 日募集资金累计投入金额与承诺投入金额的差额为 583.73 万元，大于承诺投入金额系使用募集资金存放专项账户结余资金产生的利息收入支付投资款项。

[注 3] “年产 180 万片集成电路用 12 英寸硅片”项目 2023 年度实现营业收入 32,083.50 万元，实现毛利-24,710.34 万元，实现净利润-30,240.58 万元。报告期内，受国际形势和宏观经济环境等因素的影响，公司所处半导体行业景气度下滑，市场需求疲软，该项目产能亦未能完全释放且销售价格与预期的价格有一定差异，导致本项目未达到预计效益。

[注 4] “年产 240 万片 6 英寸硅外延片技术改造”项目 2023 年度受国际形势和宏观经济环境等因素的影响，公司所处半导体行业景气度下滑，市场需求疲软，2023 年度 6 英寸硅外延片销售价格下降，产能亦未能完全释放，导致本项目未达到预计效益。

附件 1-2

募集资金使用情况对照表

(2022 年 11 月立昂转债)

2023 年度

编制单位：杭州立昂微电子股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额		339,000.00		本年度投入募集资金总额		74,726.96						
变更用途的募集资金总额		不适用		已累计投入募集资金总额		176,963.47						
变更用途的募集资金总额比例		不适用										
承诺投资项目	已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	截至期末承诺投入金额	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2) [注 1]	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3) = (2) - (1)	截至期末投入进度(%) (4) = (2) / (1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
年产 180 万片 12 英寸半导体硅外延片项目	-	113,000.00	113,000.00	未做分期承诺	11,900.17	20,176.29	不适用	17.86	2026 年 5 月[注 2]	不适用	不适用	否
年产 600 万片 6 英寸集成电路用硅抛光片项目	-	125,000.00	125,000.00	未做分期承诺	29,890.65	56,812.78	不适用	45.45	2026 年 5 月[注 2]	不适用	不适用	否
补充流动资金	-	101,000.00	101,000.00	未做分期承诺	32,936.14	99,974.40	不适用	98.98	不适用			否
合 计		339,000.00	339,000.00		74,726.96	176,963.47		52.20				
未达到计划进度原因				受外部宏观经济环境影响，公司所处行业市场景气度偏弱，导致市场需求下降，公司部分募集资金投资项目建设进度有所延迟，整体建设进度未达预期。结合相关项目建设的实际情况及未来业务发展的规划，经审慎研究，2024 年 4 月 22 日公司第								

	<p>四届董事会第三十二次会议和第四届监事会第二十四次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的议案》，在不改变项目实施主体、募集资金投资用途及募集资金投资规模等的情况下，对发行可转换公司债券募集资金投资项目“年产 180 万片 12 英寸半导体硅外延片项目”和“年产 600 万片 6 英寸集成电路用硅抛光片项目”进行延期，同意将前述募集资金投资项目的建设期由 2024 年 5 月延长至 2026 年 5 月。本次延期未改变募投项目的内容、投资用途、投资总额和实施主体，不会对募投项目的实施造成实质性影响。未来公司将加快募投项目的建设进度，以保障募投项目顺利实施。</p>
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>为保障募集资金投资项目顺利执行，在募集资金到位之前，公司根据项目建设的需要，已使用自有资金先行投入募投项目。公司 2022 年 12 月 16 日第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金人民币 16,099.06 万元，置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。上述募集资金置换情况已由中汇会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于杭州立昂微电子股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(中汇会鉴[2022]7724 号)。上述募集资金已于 2022 年 12 月 27 日全部置换完毕。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>2023 年度，公司存在使用 45,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。截止 2023 年 12 月 31 日，公司仍有 45,000.00 万元暂时补充流动资金的闲置募集资金尚未归还。</p>
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	公司 2023 年度不存在用闲置募集资金进行现金管理的情况。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
项目资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	不适用

[注 1] 公司 2022 年 11 月发行可转债募集资金投资项目截至 2023 年 12 月 31 日募集资金累计投入金额 176,963.47 万元，该金额不包含已支付的发行费用 1,187.59 万元。

[注 2] 受外部宏观经济环境影响，公司所处行业市场景气度偏弱，导致市场需求下降，公司部分募集资金投资项目建设进度有所延迟，整体建设进度未达预期。结合相关项目建设的实际情况及未来业务发展的规划，经审慎研究，2024 年 4 月 22 日公司第四届董事会第三十二次会议和第四届监事会第二十四次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的议案》，在不改变项目实施主体、募集资金投资用途及募集资金投资规模等的情况下，对发行可转换公司债券募集资金投资项目“年产 180 万片 12 英寸半导体硅外延片项目”和“年产 600 万片 6 英寸集成电路用硅抛光片项目”进行延期，同意将前述募集资金投资项目的建设期由 2024 年 5 月延长至 2026 年 5 月。本次延期未改变募投项目的内容、投资用途、投资总额和实施主体，不会对募投项目的实施造成实质性影响。未来公司将加快募投项目的建设进度，以保障募投项目顺利实施。